

北京君正集成电路股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资标的：荣芯半导体（宁波）有限公司（以下简称“荣芯半导体”或“标的公司”）。

2、投资金额：北京君正集成电路股份有限公司拟以自有资金现金方式对荣芯半导体增资 2 亿元人民币，以本轮增资规模人民币 40 亿元计算，预计本次增资完成后公司将持有其约 1.91% 的股权。

3、本次向荣芯半导体增资构成关联交易。

4、本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

为持续推进北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的半导体产业链布局，优化供应链资源配置，经公司 2026 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，公司拟对荣芯半导体（宁波）有限公司（以下简称“荣芯半导体”）进行增资，并与荣芯半导体及其他相关股东共同签署《荣芯半导体（宁波）有限公司增资协议》。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为进一步完善公司半导体产业链布局，优化供应链资源配置，打造更具韧性的供应链体系，公司拟以现金方式对荣芯半导体增资 2 亿元认购荣芯半导体新增注册资本人民币 6,436,042 元，以本轮增资规模人民币 40 亿元计算，预计本次增

资完成后公司将持有其约 1.91%的股权。具体以各方最终签署的协议约定为准。

（二）关联交易情况

过去十二个月内曾任公司董事的虞仁荣先生为豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“豪威集团”）控股股东、实际控制人、董事长，本次豪威集团拟以现金方式对荣芯半导体增资 10 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次对外投资构成与关联方共同投资的关联交易。

过去十二个月内曾任公司独立董事的刘越女士过去十二个月内在荣芯半导体曾任董事职务，荣芯半导体系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次对外投资构成对关联方投资的关联交易。

（三）审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

经独立董事认真审查，认为：本次关联交易符合公司经营发展和长期发展战略的需要；本次关联交易采用协商定价的方式，通过与标的公司现有股东及本轮其他投资人共同协商确定标的公司本轮的投前估值，符合行业惯例及市场化定价原则；本次关联交易有利于加强公司上游产业链资源，优化公司资源配置，符合公司长期发展利益，不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核，认为本次关联交易遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形，本次关联交易符合公司长远发展规划和全体股东的利益。综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司召开第六届董事会第十次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

（四）本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）豪威集成电路（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：9131000066244468X3

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2007年05月15日

法定代表人：高文宝

注册资本：121442.6982万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层

经营范围：集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东情况（截至2025年9月30日）：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	虞仁荣	27.64

关联关系情况：豪威集成控股股东、实际控制人、董事长虞仁荣先生在过去十二月内担任公司董事，豪威集团系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

是否为失信被执行人：否

（二）荣芯半导体（宁波）有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2J5X451A

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年04月02日

法定代表人：吴胜武

注册资本：41452.2292万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道金水桥路28号4幢1号1层-1

经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第一大股东情况：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	青岛民蕊投资中心（有限合伙）	14.47

关联关系情况：过去十二个月内曾任公司独立董事的刘越女士过去十二个月内曾在荣芯半导体任董事职务，荣芯半导体系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次交易构成对关联方投资的关联交易。

是否为失信被执行人：否

三、关联交易标的基本情况

（一）出资方式

本次关联交易出资方式为，公司使用自有资金现金对荣芯半导体增资 2 亿元人民币认购荣芯半导体新增注册资本人民币 6,436,042 元，以本轮增资规模人民币 40 亿元计算，预计本次增资完成后公司将持有其约 1.91% 的股权。本次关联交易不会对公司日常资金周转造成不利影响，亦不存在对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响的情形。

（二）标的公司基本情况

荣芯半导体成立于 2021 年 4 月，是国内率先采用市场化资本运作模式的 12 英寸集成电路晶圆代工企业，专注布局 28 至 180 纳米成熟制程特色工艺赛道，主营业务包括数模混合、模拟类和逻辑类集成电路的晶圆代工，重点覆盖图像传感器、模拟芯片及数模混合芯片等特色工艺代工领域，以及应用于 AI 相关领域的感存算芯片等边缘侧逻辑芯片及算力芯片的代工业务，已成功搭建或布局规划多个核心技术工艺平台，代工产品应用于 AI 算力与智能设备、工业控制、消费电子、数字家庭、移动通信、汽车电子等多元应用场景。

荣芯半导体基本情况参见“二、关联方基本情况”之“（二）荣芯半导体（宁波）有限公司”。

（三）标的公司股权结构

荣芯半导体目前无实际控制人，在目前的股权结构下，荣芯半导体的日常运营与战略执行依赖于其专业的核心管理团队。荣芯半导体核心研发及运营团队具有 20 余年的半导体行业从业经验，曾任职于国内外知名晶圆厂的关键岗位，团队具备晶圆厂筹建经验、逻辑及模拟关键/特殊工艺研发经验、晶圆厂设计服务经验、工厂管理运营经验等晶圆厂生产运营核心经验。

前十大股东持股情况：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	持股比例（%）
1	青岛民蕊投资中心（有限合伙）	6,000	14.47
2	宁波长泽投资合伙企业（有限合伙）	4,800	11.58
3	西藏智通创业投资有限公司	4,000	9.65
4	北京酷讯科技有限公司	3,600	8.68
5	珠海鳌澜股权投资合伙企业（有限合伙）	3,600	8.68
6	苏州璞华致荣创业投资合伙企业（有限合伙）	2,800	6.75
7	平潭冯源容芯股权投资合伙企业（有限合伙）	2,320	5.60
8	宁波德贤企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000	4.82
9	井冈山齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	4.82
10	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）	1,600	3.86

（四）财务信息

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	942,818.41	778,205.41
负债总额	224,507.25	261,867.77
所有者权益总额	718,311.16	516,337.63
资产负债率	23.81%	33.65%

科目	2024 年度（经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	30,281.50	30,327.87
净利润	-137,510.33	-201,973.52

注：1、上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、荣芯半导体所属晶圆代工行业前期投资较大，投资时间长，机器设备折旧摊销规模较大，对其账面净利润影响较大。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价在参考标的公司上一轮融资投后估值的基础上，充分考虑当前同行业可比公司的估值水平后，采用协商定价方式，经与标的公司现有股东及本轮其他投资人共同协商确定。

截至 2025 年 12 月 31 日，A 股市场中主营业务与标的公司相近的晶圆代工上市公司市净率 PB（MRQ）介于 3 倍至 4.4 倍的区间范围内。

本次交易中，荣芯半导体投前估值按 130 亿元人民币计算，对应其截至 2025 年末归属于母公司所有者权益的市净率约为 2.5 倍，低于前述 A 股可比公司的市净率区间下限。考虑到荣芯半导体与上市公司在股票流动性、运作平台及经营成熟度等方面客观上存在一定差异，非上市股权交易通常会体现为一定的流动性折价，因此，在综合考量流动性因素及企业个体发展差异后，本次交易的估值基本符合同行业上市公司的估值水平。

综上，本次关联交易定价合理、公允，遵循交易公平原则，符合行业惯例及市场化定价原则，公司已按照相关规定履行批准程序，本次关联交易不会影响公司的正常运营，不存在损害中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易拟签订的《增资协议》核心条款如下所示，具体内容以各方最终签署的协议为准。

（一）合同主体

公司与荣芯半导体、荣芯半导体现有股东，荣芯半导体其他本轮投资人。

（二）交易价格

各方兹同意，按照本次投资前标的公司估值人民币 130 亿元进行本轮增资，标的公司本轮增资规模为人民币 40 亿元。标的公司同意按照约定由本轮投资人认购总增资额相应增加注册资本。

（三）支付方式及期限

标的公司应于先决条件满足日后两（2）个工作日内向本轮投资人交付相应的书面通知，告知相应的先决条件已满足并提供所有证明文件。本轮投资方自收到先决条件已满足的书面通知和所有证明文件日后的5个工作日内或在各方一致同意的时间，以网银转账方式向标的公司指定的银行账户一次性转账当期对应投资款。

（四）增资变更登记及交割

1、自先决条件满足日起且分别收到本轮投资人足额缴纳的所有出资投资款后的20个工作日内，标的公司需就本轮增资在市场监督管理局办理完成相应的变更登记手续、取得新的营业执照。本轮投资人足额缴纳投资款之日为投资款所对应的股权的交割日。

2、在交割日，共同保证方应当或应促使相关方向本轮投资人交付相应的收据以及更新后的股东名册、出资证明书等交易文件。

各方同意，对于每一本轮投资人而言，自交割日起，本轮投资人即成为标的公司持有对应该等本轮投资人全部的增资额的股东，并按照本协议、股东协议和公司章程的规定就其持有对应该等本轮投资人全部的增资额，享有一切股东权利（包括该本轮投资人有权按其持有对应该等本轮投资人的全部的增资额所对应标的公司的持股比例享有对标的公司以前全部年度及增资形成的全部所有者权益以及未分配的滚存利润）。

（五）违约责任

如果协议的一方（“违约方”）违反协议或其作为合同方的其他交易文件，包括违反其在该等文件中所作的陈述和/或保证或未履行其在该等文件项下的任何义务或承诺，致使未违约的本协议或其他交易文件的当事方（“受损方”）蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对受损方作出赔偿，并应当采取相应措施，使受损方免受任何进一步的损害。

对于本轮投资人遭受或产生的以下任何事项所导致或引起的损失，共同保证方应连带赔偿本轮投资人：

- 1、任何共同保证方违反了其任何共同保证；
- 2、任何共同保证方违反了本协议项下的任何承诺、约定或其它义务；或

3、任何共同保证方违反了其为一方的其它交易文件。

（六）生效及终止

1、协议自各方签署本协议之日起生效。

2、协议在交割日前可因如下情形被终止：

（1）经各方一致书面同意终止；

（2）根据本协议其他条款约定终止；

（3）如果一方严重违反本协议的重要规定，而该违反无法被纠正或者没有在其他方发出书面通知后二十（20）个工作日内得到纠正，其他方有权书面通知终止本协议。

六、本次关联交易的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次关联交易的目的

公司自上市以来，在保证日常运营不受影响的情况下，陆续使用部分闲置自有资金进行了一些股权投资基金的投资，总体获得了良好的财务收益。

2020年公司完成对北京矽成半导体有限公司的重大资产重组后，公司资金规模得到大幅提高，产品种类、技术与市场领域等均有了较大扩展。在此情形下，公司拟持续推进半导体产业链布局，通过对上游供应链的投资，优化供应链资源配置，构建更具韧性的供应链体系，在保障主营业务稳健发展的基础上，进一步完善公司整体供应链布局。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司自成立以来，一直专注于集成电路相关技术和产品的研发与销售，本次对荣芯半导体投资属于公司对半导体上游供应链的布局，有助于公司更好地拓展上游供应链资源。本次投资金额占公司总资产及净资产的比例较小，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次关联交易存在的风险

1、公司正在与标的公司及本轮其他投资方就标的公司本次增资事项进行沟通，相关协议尚未正式签署，最终投资方案需经各投资方内部决策程序审批通过

后方可生效，公司在本次交易后持有标的公司股权比例以最终签署的增资协议约定内容为准。

2、本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响，存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。

3、标的公司所处的 12 英寸晶圆代工行业属于技术密集型和资本密集型行业，存在技术迭代快、市场竞争加剧、产能利用率波动等经营风险。同时，本次投资属于产业链上下游的战略协同布局，后续能否在产品协同、供应链合作方面达到预期效果，存在一定的不确定性。

4、标的公司所处的晶圆代工行业属于重资产投入行业，前期在产能爬坡过程中，会出现由于折旧规模较大但规模效益尚未显现而出现较大亏损的情况。标的公司未来几年折旧费用与研发费用还将持续处于较高水平，亏损状态可能持续存在。标的公司估值可能因此出现变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

至本次关联交易为止，当年年初至披露日公司与上述关联方未进行其他关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

八、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事专门会议决议；
- (三) 标的公司审计报告；
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日